特 笛 協 力 条 約

PCT

国際予備審査報告

REC'D 3 0 OCT 2003

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の客類記号 FP365PCT	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP03/08476	国際出願日 (日.月.年) 03.07.03	優先日 (日. 月. 年)			
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷	H05K3/28				
出願人(氏名又は名称) 株式会社日立製作所					
2. この国際予備審査報告は、この表 この国際予備審査報告には、 査機関に対してした訂正を含 (PCT規則70.16及びPCT この附属書類は、全部で	紙を含めて全部で3 附属書類、つまり補正されて、この報む明細書、請求の範囲及び/又は図面で実施細則第607号参照)	告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審			
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 I 図 国際予備審査報告の基礎 II					
国際予備審査の請求書を受理した日 03.07.03 名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/J) 郵便番号100-891 東京都千代田区霞が関三丁目	ウェー	報告を作成した日 3.10.03 (権限のある職員) 3S 9341 (第2) 3-3581-1101 内線 3389			

I. 国際予備審査報告の基礎	
1. この国際予備審査報告は下記の出願告類に基づいて作成され 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書によ PCT規則70.16,70.17)	れた。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。
X 出願時の国際出願書類	
明細書 第 ページ、 明細書 第 ページ、 明細書 第 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求費と共に提出されたもの 付の啓簡と共に提出されたもの
請求の範囲 第 項、 請求の範囲 第 項、 請求の範囲 第 項、 請求の範囲 第 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求費と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
図面 第 ページ/図、 図面 第 ページ/図、 明細書の配列表の部分 ポージ	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求事と共に提出されたもの
明細費の配列表の部分第 ページ、明細費の配列表の部分第 ページ、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この	
上記の書類は、下記の言語である 語である 語である	う翻訳文の言語
3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んで	おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。
書の近山があった 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによがあった。	出された辔面による配列表
4. 補正により、下記の書類が削除された。 □ 明細書 第ページ □ 請求の範囲 第項 □ 図面 図面の第 ペー	· ジ/図
5. □ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正れるので、その補正がされなかったものとして作成した。 記1. における判断の際に考慮しなければならず、本報	。(PCT規則70.2~) この緒正を今か業に辞ら田郷はし

围	際予	借	來:	杏椒	生

国際出願番号 PCT/JP03/08476

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条 (PCT35条(2)) に定める見解、そ文献及び説明 1. 見解 新規性 (N)	0410
新規性 (N)	れを裏付ける
 遺歩性(IS) 簡求の範囲 直求の範囲 直求の範囲 直求の範囲 1-14 請求の範囲 2. 文献及び説明(PCT規則70.7) コネクタと部品実装基板とが金属リードによって接続されたモジュール装置で、コネクタ、金属リード、及び、電子部品とを、硬化前の形態が40℃以で固体である同一の熱硬化性樹脂で封止し、かつ、電子部品を封止する前言さが各電子部品の高さに応じて変化するように形成した点については、国際で引用された何れの文献にも開示されておらず、当業者にとって自明なもので引用された何れの文献にも開示されておらず、当業者にとって自明なもの 	
産業上の利用可能性 (IA)	
間求の範囲 2. 文献及び説明 (PCT規則70.7) コネクタと部品実装基板とが金属リードによって接続されたモジュール装置 て、コネクタ、金属リード、及び、電子部品とを、硬化前の形態が40℃以で固体である同一の熱硬化性樹脂で封止し、かつ、電子部品を封止する前部 さが各電子部品の高さに応じて変化するように形成した点については、国際 で引用された何れの文献にも開示されておらず、当業者にとって自明なもの	有 無
コネクタと部品実装基板とが金属リードによって接続されたモジュール装置て、コネクタ、金属リード、及び、電子部品とを、硬化前の形態が40℃以で固体である同一の熱硬化性樹脂で封止し、かつ、電子部品を封止する前部さが各電子部品の高さに応じて変化するように形成した点については、国際で引用された何れの文献にも開示されておらず、当業者にとって自明なもの	有
コネクタと部品実装基板とが金属リードによって接続されたモジュール装置て、コネクタ、金属リード、及び、電子部品とを、硬化前の形態が40℃以で固体である同一の熱硬化性樹脂で封止し、かつ、電子部品を封止する前言さが各電子部品の高さに応じて変化するように形成した点については、国際で引用された何れの文献にも開示されておらず、当業者にとって自明なものない。	<u> </u>
'ΔV' ₀	量におい 以下の温度 己樹脂の厚 祭調査報告 ひと
	•